

盛合晶微半导体有限公司
关于公司及全资子公司为全资子公司
提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
澄芯集成技术（江阴）有限公司	98,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次新增担保对象	否

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	250,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	17.33
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保障“多层细线宽系统集成封测项目（一期）”的实施，盛合晶微半导体有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司澄芯集成技术（江阴）有限公司（以下简称“澄芯集成”）拟向国家开发银行申请不超过人民币 9.8 亿元的新型政策性金融工具借款，期限不超过 10 年（具体以实际签署的合同为准）。新型政策性金融工具借款资金将通过增资注入公司全资子公司盛合晶微半导体（江阴）有限公司（以下简称“盛合晶微江阴”）作为“多层细线宽系统集成封测项目（一期）”资本金，并由盛合晶微江阴为上述新型政策性金融工具借款提供还款资金差额补足，公司提供连带责任担保，本次担保不涉及反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司澄芯集成拟借款并由子公司盛合晶微江阴提供差额补足及公司提供担保的议案》，同意澄芯集成向国家开发银行申请不超过人民币 9.8 亿元的新型政策性金融工具借款，由盛合晶微江阴提供还款资金差额补足，公司提供连带责任担保。本事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	澄芯集成技术（江阴）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	崔东
统一社会信用代码	91320281MAD67P0885
成立时间	2023 年 12 月 1 日
注册地	无锡市江阴市蟠龙山路 109 号
注册资本	3,000 万美元
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）

经营范围	一般项目：集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；技术进出口；货物进出口；供应链管理服务；企业总部管理；基于云平台的业务外包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	23,095.14	25,422.44
	负债总额	4,083.33	5,505.57
	资产净额	19,011.81	19,916.87
	营业收入	4,011.51	30,947.57
	净利润	-907.16	-1,398.46

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司及盛合晶微江阴拟提供的担保额度，具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。公司董事会授权管理层或其指定人员根据实际情况办理上述事宜，签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于新型政策性金融工具的落实和推进的契机，为保障“多层细线宽系统集成封测项目（一期）”的实施而发生，被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险总体可控，不影响公司正常生产经营，不涉及关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：上述担保事项有助于为“多层细线宽系统集成封测项目(一期)”提供资金支持，符合公司的整体发展需要。被担保对象为公司全资子公司，担保风险总体可控，不影响公司正常生产经营，不涉及关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保额度总额为 250,000.00 万元（不含本次审批的担保额度），占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例是 17.33%和 11.06%，公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日